

Infoblatt Leiterplatte

- Von der Layouterstellung bis zur elektrisch geprüften Leiterplatte
- Entflechten von einseitigen, doppelseitigen und Multilayer-Platinen
- Leiterplattendesign mit aktueller Version von EAGLE Layout Editor (CadSoft)

Vorlagen der Leiterplattenfertigung

- Stromlaufplan, Daten aus EDA- oder CAD-Programmen, Filmvorlagen oder Muster
- Datenformate: Extended-Gerber, Board-Dateien (Eagle, Altium, Protel, Target ...)

Ausführungen

- Basismaterialien

FR4	Epoxidharz-Glashartgewebe
FR4 HT	Epoxidharz-Glashartgewebe, Tg>170° C
AL	Aluminiumleiterplatten mit FR4-Prepregs
PTFE	Teflonleiterplatten für HF-Anwendungen
- Lagen

1 - seitig , 2 - seitig, Multilayer

- Abmessungen

Basismaterial	0.5 - 0.8 - 1.0 - 1.5 -2.0 - 2.5 mm
Cu-Dicke	18 - 35 - 70 - 105 µm
max. Maße	520 mm x 360 mm
Leiterbahnbreiten und -abstände	> 150µm
Bohrungsdurchmesser	> 0,3mm
- Oberflächen

HAL bleifrei, RoHS konform
chemisch Sn, chemisch Ni/Au
galvanisch Ni/Au partiell oder vollflächig
- Mechanische Bearbeitung

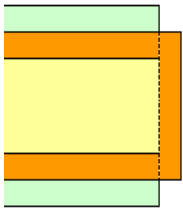
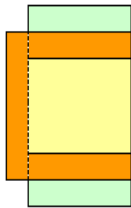
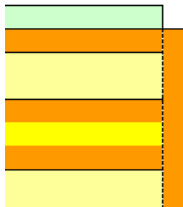


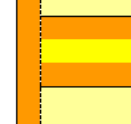
Ritzen (Kerbfräsen), Kontur gefräst, Stegfräsen

- Zusatzdrucke

Lötstopplack fotosensitiv / 2K-Lack
Farben grün (Standard), schwarz, weiß, rot, blau
Positionsdruck gelb, weiß; Lötdecklack blau
- Prüfung

elektrische Prüfung, 100% optische Prüfung
gemäß IPC-A-600-H

Standard Lagenaufbau

		<u>Aufbau / Abmessungen in mm</u>	
▪ Doppelseitige Platine	L1		Cu 18µ + Galvanik 0,035
	L2		Cu 18µ + Galvanik 0,035
			FR4 1.5mm 1,500
			<u>1,57</u>
▪ Multilayer 4-lagig	L1		Cu 18µ + Galvanik 0,043
	I1		Prepreg 2x 7628M 0,400
	I2		Cu Kern 35µ 0,035
			Kern 0,65mm 0,650
	L2		Cu Kern 35µ 0,035
			Prepreg 2x 7628M 0,400
			Cu 18µ + Galvanik 0,043
			<u>1,60</u>